

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-038

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现营业收入 43,497.08 万元至 45,090.38 万元，与上年同期相比，同比增长 36.50%至 41.50%。

2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,888.05 万元至 10,251.42 万元，与上年同期相比，同比增加 36.06%至 41.06%。

3、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 9,549.76 万元至 9,887.57 万元，与上年同期在相比，同比增加 41.35%至 46.35%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023 年半年度营业收入：31,865.99 万元。

2023 年半年度归属于母公司所有者的净利润：7,267.42 万元。

2023 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6,756.11 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、PCB 领域：

在 PCB 领域，受益于大算力时代，产品升级&出口双轮驱动，公司紧握行业升级及国产替代趋势，从研发和扩产两个维度加强 PCB 设备的产品升级，推动多层板、HDI 板、柔性板以及 IC 载板等中高端 PCB 产品市场份额占比不断提升，同步加大高端阻焊市场的 NEX 系列直写光刻设备的扩产。

出口链方面，公司已提前部署了全球化海外策略，加大了东南亚地区的市场布局，目前已完成泰国子公司的设立登记。同时，公司积极建设海外销售及运维团队，发挥自身品牌、技术开发和市场营销的优势，增强海外客户的服务能力。

2、泛半导体领域：

在泛半导体领域，公司持续多赛道拓展，丰富产品矩阵丰富，推进直写光刻技术应用拓展不断深化。今年先进封装设备增速不错，载板设备持续平稳增长，显示设备今年也有不错进展。同时，作为技术创新驱动型公司，公司持续推进前沿技术研发，紧握多重行业机遇，不断推出新品，包括键合、对准、激光钻孔设备，对泛半导

体业务未来增长都有着稳定的产品和市场支撑。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日